

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 757 810**

51 Int. Cl.:

H04M 1/02 (2006.01)

G06F 1/16 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **19.03.2018 E 18162572 (4)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **09.10.2019 EP 3407580**

54 Título: **Soporte para componente electrónico, montaje de componentes electrónicos y terminal móvil**

30 Prioridad:

24.05.2017 CN 201710377937
24.05.2017 CN 201720595689 U

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

30.04.2020

73 Titular/es:

**GUANGDONG OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. (100.0%)
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan
Guangdong 523860, CN**

72 Inventor/es:

**QIU, ZESHUO;
JIANG, YU;
YANG, JING y
CHEN, QIANQIANG**

74 Agente/Representante:

GARCÍA GONZÁLEZ, Sergio

ES 2 757 810 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Soporte para componente electrónico, montaje de componentes electrónicos y terminal móvil

5 **Campo**

La presente divulgación se refiere al campo de los aparatos electrónicos, y más particularmente a un soporte para un componente electrónico, un montaje de componentes electrónicos y un terminal móvil.

Antecedentes

10 Con el desarrollo de las tecnologías, los componentes integrados de forma interna en un terminal móvil se incrementan para realizar diversas funciones y, en consecuencia, el espacio dentro del terminal móvil se vuelve cada vez más compacto.

Durante el montaje y el desmontaje del terminal móvil, el inventor se dio cuenta de que un componente electrónico y una unidad de cámara ocupan un gran espacio interior en el terminal móvil, lo que es negativo para la disposición de otros componentes dentro del terminal móvil.

15 De acuerdo con el documento US 20140063821A1, se describe un ensamblaje del dispositivo y sistemas y procedimientos para usar el mismo. El ensamblaje del dispositivo puede incluir una placa base, múltiples paredes laterales y una o más capas aislantes dispuestas en las paredes laterales. Cuando se acopla a un módulo, el ensamblaje del dispositivo puede contener al menos parcialmente el módulo para evitar la propagación de EMI, para ayudar en la disipación de calor, para proteger la integridad estructural del módulo y similares.

20 De acuerdo con el documento US 20150382494A1, una estructura de montaje del dispositivo embutida de acceso de liberación rápida incluye una carcasa de soporte rígida que incluye una cámara de alojamiento rodeada por un panel inferior y dos paneles laterales opuestos al mismo, un primer elemento de posicionamiento y un primer elemento de localización situado en el panel inferior y definiendo un espacio de montaje entre los mismos, un segundo elemento de posicionamiento y un segundo elemento de localización situado respectivamente en los dos paneles laterales, y un mecanismo de retención que incluye una primera placa de retención fijada al primer elemento de posicionamiento y adaptada para asegurar de forma desmontable un pequeño dispositivo de acceso en el espacio de montaje y una segunda placa de retención fijada al segundo elemento de localización y adaptada para asegurar de forma desmontable un dispositivo de acceso grande en la cámara de alojamiento.

Sumario

30 Un objetivo de la presente divulgación es proporcionar un soporte para un componente electrónico, un montaje de componentes electrónicos y un terminal móvil que puede ahorrar espacio.

Para resolver el problema técnico anterior, la presente divulgación proporciona un soporte para componente electrónico de acuerdo con la reivindicación 1.

Otro aspecto de la presente invención se divulga de acuerdo con las reivindicaciones dependientes.

35 **Breve descripción de los dibujos**

Para describir las soluciones técnicas en la presente divulgación más claramente, a continuación, se presentarán brevemente los dibujos adjuntos necesarios para la descripción de las realizaciones. Lógicamente, los dibujos adjuntos descritos a continuación muestran algunas realizaciones de la presente divulgación, y los expertos en la técnica pueden obtener otros dibujos basados en estos dibujos sin necesitar esfuerzos creativos.

40 Fig. 1 es una vista esquemática de un terminal móvil provisto con una realización de la presente divulgación.

Fig. 2 es una vista parcial del terminal móvil ilustrado en la Fig. 1.

Fig. 3 es una vista en despiece del terminal móvil ilustrado en la Fig. 2.

Fig. 4 es una vista en sección de un soporte para un componente electrónico ilustrado en la Fig. 2.

Descripción detallada

45 Las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente divulgación se describirán clara y completamente a continuación con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de la presente divulgación.

La presente divulgación proporciona un soporte para componente electrónico, que incluye:

una parte de soporte configurada para sostener un componente electrónico; y

50 dos paredes laterales dispuestas de forma opuesta y dispuestas en el mismo lado de la parte de soporte, las dos paredes laterales del soporte están configuradas para disponerse en una placa base y definir junto con la placa base y la parte de soporte un espacio de alojamiento; el espacio de alojamiento está configurado para alojar al menos parcialmente una primera placa de circuito flexible conectada eléctricamente al componente electrónico, y la primera placa de circuito flexible está conectada eléctricamente a la placa base.

La presente divulgación proporciona además el montaje de componentes electrónicos, que incluye el componente electrónico y el soporte para el componente electrónico; el soporte incluye la parte del soporte y las dos paredes laterales, las dos paredes laterales están dispuestas de manera opuesta, la parte de soporte sostiene el componente electrónico; las dos paredes laterales están dispuestas en el mismo lado de la parte de soporte, las dos paredes laterales del soporte están configuradas para disponerse en la placa base y definen, junto con la placa base y la parte de soporte, el espacio de alojamiento.

La presente descripción proporciona además el terminal móvil, que incluye la placa base y el montaje de componentes electrónicos como se ha mencionado anteriormente, el espacio de alojamiento está configurado para alojar al menos parcialmente una primera placa de circuito flexible conectada eléctricamente al componente electrónico, y la primera placa de circuito flexible está configurada para estar conectada eléctricamente a la placa base.

Un terminal móvil 100 de acuerdo con las realizaciones de la presente divulgación puede ser cualquier aparato que tenga funciones de comunicación y almacenamiento, como, por ejemplo, una tableta electrónica, un teléfono móvil, un lector electrónico, un control remoto, un ordenador personal (PC), un ordenador portátil, un aparato de a bordo, una televisión con acceso a internet, un aparato portátil u otros aparatos inteligentes con función de internet.

Con referencia a las Figs. 1 a 3, la presente divulgación proporciona el terminal móvil 100, y el terminal móvil 100 incluye un montaje de componentes electrónicos 1 y una placa base 2. El montaje de componentes electrónicos 1 incluye un componente electrónico 12 y un soporte 11 para un componente electrónico. El soporte 11 incluye una parte de soporte 111 y dos paredes laterales 112. Las dos paredes laterales 112 están dispuestas de forma opuesta. La parte de soporte 111 sostiene el componente electrónico 12. Las dos paredes laterales 112 están dispuestas en el mismo lado de la parte de soporte 111. Las dos paredes laterales 112 del soporte 111 están configuradas para estar dispuestas en la placa base 2 y definen junto con la placa base 2 y las dos paredes laterales 112 un espacio de alojamiento 113. El espacio de alojamiento 113 está configurado para alojar al menos parcialmente una primera placa de circuito flexible 13 conectada eléctricamente al componente electrónico 12, y la primera placa de circuito flexible 13 está conectada eléctricamente a la placa base 2.

Específicamente, la placa base 2 está configurada para sostener varios componentes y proporcionar pasos para los diversos componentes. Por ejemplo, dos componentes están conectados eléctricamente entre sí a través de un cable de cobre en la placa base 2. El montaje de componentes electrónicos 1 también está conectada eléctricamente a la placa base 2.

Específicamente, la parte de soporte 111 incluye una primera superficie 111a y una segunda superficie 111b dispuestas de manera opuesta. El componente electrónico 12 está fijado a la primera superficie 111a de la parte de soporte 111, las dos paredes laterales 112 están dispuestas en la segunda superficie 111b de la parte de soporte 111. Las dos paredes laterales 112 del soporte 111 están fijadas a la placa base 2, y el soporte y la placa base 2 definen el espacio de alojamiento 113 configurado para alojar el componente.

Debe entenderse que el componente electrónico 12 es un sensor de luz. Ciertamente, en otras realizaciones, el componente electrónico 12 también puede ser algún otro componente, como, por ejemplo, un sensor de distancia, un receptor de teléfono, etc.

Al aplicar el soporte 11, puede proporcionarse una superficie superior y una superficie inferior de la parte de soporte 111 del soporte 11 con el componente electrónico 12 y otros componentes (como, por ejemplo, una segunda placa de circuito flexible 14 conectada eléctricamente a una unidad de cámara), en consecuencia, mejorando de este modo la utilización del espacio.

En la presente realización, con referencia a la Fig. 3, la parte de soporte 111 incluye una primera sub-placa 1111 y una segunda sub-placa 1112 conectada integralmente, la primera sub-placa 1111 tiene una forma rectangular, la segunda sub-placa 1112 se extiende y gradualmente se estrecha en una dirección alejada de la primera sub-placa 1111, y las dos paredes laterales 112 están dispuestas en consecuencia en dos bordes de la primera sub-placa 1111 dispuestas de manera opuesta. El componente electrónico 12 está configurado para ser fijado a la primera sub-placa 1111, y la segunda sub-placa 1112 está configurada para sostener la primera placa de circuito flexible 13 conectada eléctricamente al componente electrónico 12.

Debe entenderse que una dirección de extensión de la segunda sub-placa 1112 se define como una dirección longitudinal L1 de la parte de soporte 111.

Con referencia a las Figs. 3 y 4, la segunda superficie 111b de la parte de soporte 111 del soporte 11 y las superficies de las dos paredes laterales 112 enfrentadas entre sí forman una superficie interna 11b del soporte 11, y la primera superficie 111a y las superficies de las dos paredes laterales opuestas entre sí forman una superficie exterior 11a del soporte 11. Cuando el soporte 11 está conectado de forma fija a la placa base 2 a través de las dos paredes laterales 112, la superficie interna 11b del soporte 11 y la placa base 2 forman el espacio de alojamiento 113, y el espacio de alojamiento 113 está configurado para alojar los componentes. El componente electrónico 12 está configurado para ser fijado a la primera superficie 111a de la parte de soporte 111 del soporte 11, y los componentes pueden ser acomodados debajo de la parte de soporte 111 del soporte 11, es decir, la disposición del soporte 11 mejora la utilización del espacio longitudinal de la placa base 2, de modo que los componentes dentro del terminal móvil 100

pueden disponerse de manera más compacta.

5 Debe entenderse que, la pared lateral 112 tiene forma de banda, las dos paredes laterales 112 están conectadas de forma vertical a los bordes de la segunda superficie 111b de la parte de soporte 111. La forma de las paredes laterales 112 y la relación de acoplamiento vertical entre las paredes laterales 112 y la parte de soporte 111 permiten que la superficie interna 11b del soporte 11 tenga una forma rectangular, y que el espacio rectangular sea grande, de modo que puedan acomodarse más componentes o que el componente tenga un área grande, mejorando de este modo aún más la utilización del espacio del terminal móvil 100. Ciertamente, en otras realizaciones, la superficie interna 11b del soporte 11 también puede ser arqueada o en forma de V, etc.

10 Debe entenderse que las dos paredes laterales 112 están adheridas a la placa base 2 a través de una cinta adhesiva de doble cara. Ciertamente, en otras realizaciones, las dos paredes laterales 112 también pueden estar conectadas a la placa base 2 a través de un tornillo o broche.

15 Además, con referencia a las Figs. 2 y 3, el montaje de componentes electrónicos 1 incluye además la primera placa de circuito flexible 13, un primer extremo de la primera placa de circuito flexible 13 está conectado al componente electrónico 12, un segundo extremo de la primera placa de circuito flexible 13 se extiende fuera de la parte de soporte 111 en una dirección alejada del componente electrónico 12, y el segundo extremo de la primera placa de circuito flexible 13 se dobla a lo largo de un borde lateral de la parte de soporte 111 y se extiende por encima de la segunda superficie 111b de la parte de soporte 111 y dentro del espacio de alojamiento 113. El componente electrónico 12 está conectado eléctricamente a la placa base 2 del terminal móvil 100 a través de la primera placa de circuito flexible 13, de modo que el componente electrónico 12 no necesita ser soldado a la placa base 2 y se evita que sea dispuesto directamente a la placa base 2 para ocupar el espacio de la placa base 2.

20 Debe entenderse que, el primer extremo de la primera placa de circuito flexible 13 está conectado eléctricamente al componente electrónico 12, una parte de la primera placa de circuito flexible 13 conectada al componente electrónico 12 está adherida a la primera sub-placa 1111, el segundo extremo de la primera placa de circuito flexible 13 se extiende hacia la segunda sub-placa 1112, es decir, la primera placa de circuito flexible 13 está fijada a la segunda sub-placa 1112, y una parte excedente de la primera placa de circuito flexible 13 en una longitud comparada con la segunda sub-placa 1112 se dobla a lo largo del borde lateral de la segunda sub-placa 1112 y se extiende dentro del espacio de alojamiento 113, sin ocupar un espacio en la dirección longitudinal L1 de la parte de soporte 111. La estructura que se estrecha gradualmente de la segunda sub-placa 1112 de la parte de soporte 111 permite que la primera placa de circuito flexible 13 se doble y se extienda dentro del espacio de alojamiento 113, facilitando de este modo las disposiciones del sensor de luz y de la primera placa de circuito flexible 13.

25 Debe entenderse que, el montaje de componente electrónico 1 incluye además un conector eléctrico, y el conector eléctrico está configurado para conectarse entre el segundo extremo de la primera placa de circuito flexible 13 lejos del componente electrónico 12 y la placa base 2 del terminal móvil 100. Específicamente, el segundo extremo de la primera placa de circuito flexible 13 está conectado al conector eléctrico, es decir, la primera placa de circuito flexible 13 está conectada a la placa base 2 a través del conector eléctrico, asegurando de este modo un buen acoplamiento eléctrico entre el componente electrónico 12 y la placa base 2, y facilitando un acoplamiento conectable entre la primera placa de circuito flexible 13 y la placa base 2. Ciertamente, en otras realizaciones, el segundo extremo de la primera placa de circuito flexible 13 lejos del componente electrónico 12 también puede soldarse directamente a la placa base 2.

30 Para una mejora adicional, con referencia a la Fig. 3, el montaje de componentes electrónicos 1 tiene además una primera estructura 1113 de limitación de posición, la primera estructura 1113 de limitación de posición incluye dos protuberancias 1113a en forma de banda, las dos protuberancias en forma de banda 1113a sobresalen de la parte de soporte 111 y están dispuestas de manera opuesta, y el componente electrónico 12 está ubicado entre las dos protuberancias 1113a en forma de banda. Al proporcionar la primera estructura 1113 de limitación de posición, el componente electrónico 12 se fija a la parte de soporte 111 y no tiende a moverse, mejorando de este modo la fiabilidad del montaje de componentes electrónicos 1 y el terminal móvil 100.

35 Específicamente, la primera estructura 1113 de limitación de posición está dispuesta en la primera sub-placa 1111, las dos protuberancias 1113a en forma de banda se extienden ambas en la dirección longitudinal L1 de la parte de soporte 111, una distancia entre las dos protuberancias 1113a en forma de banda es la misma que el tamaño de la parte de la primera placa de circuito flexible conectada con el componente electrónico 12, por lo tanto, la parte de la primera placa de circuito flexible conectada con el componente electrónico 12 puede fijarse mejor a la primera sub-placa 1111, mejorando la fiabilidad del montaje de componentes electrónicos 1 y el terminal móvil 100.

40 Para una mejora adicional, con referencia a la Fig. 3, el soporte 11 incluye además una protuberancia de limitación 1114. La protuberancia de limitación 1114 sobresale de la parte de soporte 111, y la protuberancia de limitación 1114 está ubicada fuera de un área ocupada por las dos protuberancias 1113a en forma de banda. La primera placa de circuito flexible 13 define un orificio de limitación 13a, y la protuberancia de limitación 1114 pasa a través del orificio de limitación 13a de la primera placa de circuito flexible 13. Al proporcionar la protuberancia de limitación 1114, la primera placa de circuito flexible 13 puede fijarse mejor a la parte de soporte 111, de modo que la primera placa de circuito flexible 13 puede fijarse mejor a la parte de soporte 111, mejorando la fiabilidad del montaje de componentes electrónicos 1 y el terminal móvil 100.

5 Específicamente, la protuberancia de limitación 1114 es una protuberancia en forma de columna, la protuberancia de limitación 1114 sobresale de la segunda sub-placa 1112, es decir, la protuberancia de limitación 1114 está ubicada fuera del área ocupada por las dos protuberancias en forma de banda 1113a, y la protuberancia de limitación 1114 es adyacente a un borde de la segunda sub-placa 1112. La protuberancia de limitación 1114 pasa a través del orificio de limitación de la primera placa de circuito flexible 13, de modo que la primera placa de circuito flexible 13 puede fijarse mejor a la parte de soporte 111, mejorando la fiabilidad del montaje de componentes electrónicos 1 y el terminal móvil 100. Ciertamente, en otras realizaciones, la protuberancia de limitación 1114 también puede ser una protuberancia rectangular, o en una forma esférica y etc.

10 Debe entenderse que, con referencia a las Figs. 2 y 3, el terminal móvil 100 incluye además la segunda placa de circuito flexible 14 configurada para conectarse eléctricamente a la unidad de cámara 15, y la segunda placa de circuito flexible 14 está situada en el espacio de alojamiento 113 del soporte 11.

15 Específicamente, dado que la unidad de cámara 15 y el componente electrónico 12 por lo general están dispuestos en la dirección longitudinal L1 de la parte de soporte 111, al acomodar la segunda placa de circuito flexible 14 configurada para conectarse a la unidad de cámara 15 en el espacio de alojamiento 113 del soporte 11, se reduce una distancia entre la unidad de cámara 15 y el componente electrónico 12, se reduce una distancia entre la unidad de cámara 15 y el componente electrónico 12 en la dirección longitudinal L1 de la parte de soporte 111, y se ahorra el espacio del montaje de componentes electrónicos 1 y el terminal móvil 100.

20 Debe entenderse que, el terminal móvil 100 incluye además la unidad de cámara 15, y la unidad de cámara 15 está conectada eléctricamente a la segunda placa de circuito flexible 14.

25 Durante el montaje del terminal móvil 100, las dos paredes laterales 112 del soporte 11 se adhieren a la placa base 2 para definir el espacio de alojamiento 113 entre el soporte 11 y la placa base 2. La parte de la primera placa de circuito flexible 13 conectada con el componente electrónico 12 (el sensor de luz) está adherida a la primera sub-placa 1111. La protuberancia de limitación 1114 de la segunda sub-placa 1112 pasa a través del orificio de limitación 13a de la primera placa de circuito flexible 13. La parte de la primera placa de circuito flexible 13 que se extiende fuera de la segunda sub-placa 1112 se dobla a lo largo del borde lateral de la segunda sub-placa 1112, se extiende hacia el espacio de alojamiento 113 y se conecta eléctricamente a la placa base 2 a través del conector eléctrico, logrando el acoplamiento eléctrico entre el componente electrónico 12 y la placa base 2. Un primer extremo de la segunda placa de circuito flexible 14 está conectado a la unidad de cámara 15, y un segundo extremo de la segunda placa de circuito flexible 14 se extiende dentro del espacio de alojamiento 113 y está conectado eléctricamente a la placa base 2, logrando el acoplamiento eléctrico entre la unidad de cámara 15 y la placa base 2.

30 El soporte 11 proporcionado a través de la presente divulgación incluye la parte de soporte 111 y las dos paredes laterales 112, el componente electrónico 12 puede fijarse a la parte de soporte 111, y las dos paredes laterales 112 están dispuestas en un plano de montaje, como, por ejemplo, una superficie de la placa base 2, de modo que los componentes puedan acomodarse entre la parte de soporte 111 y el plano de montaje, es decir, los componentes, como, por ejemplo, la segunda placa de circuito flexible 14 conectada eléctricamente a la unidad de cámara 15, pueden disponerse debajo del componente electrónico 12, mejorando de este modo la utilización del espacio.

35 En el montaje de componentes electrónicos 1 y el terminal móvil 100 proporcionado por la presente divulgación, al aplicar el soporte 11 del montaje de componentes electrónicos mencionado anteriormente, la superficie superior y la superficie inferior de la parte de soporte 111 del soporte 11 pueden proporcionarse en consecuencia con el componente electrónico 12 y otros componentes (como, por ejemplo, la segunda placa de circuito flexible 14 conectada eléctricamente a la unidad de cámara 15), mejorando de este modo la utilización del espacio.

40 Lo anterior revela realizaciones preferentes de la presente divulgación, debe observarse que, también es posible para los expertos en la técnica realizar algunas mejoras y modificaciones adicionales sin apartarse del principio de la presente divulgación, y estas mejoras y modificaciones se consideran que están dentro del ámbito de la presente divulgación.

REIVINDICACIONES

1. Un soporte (11) para un componente electrónico (12), que comprende:
- 5 una parte de soporte (111) configurada para sujetar un componente electrónico (12); y
- dos paredes laterales (112) dispuestas de manera opuesta y dispuestas en el mismo lado de la parte de soporte (111), las dos paredes laterales (112) del soporte (11) están configuradas para disponerse en una placa base (2) y definir junto con la placa base (2) y la parte de soporte (111) un espacio de alojamiento (113); estando el espacio de alojamiento (113) configurado para alojar al menos parcialmente una primera placa de circuito flexible (13) conectada eléctricamente al componente electrónico (12), y estando la primera placa de circuito flexible (13)
- 10 configurada para estar conectada eléctricamente a la placa base (2);
- caracterizado porque** la parte de soporte (111) comprende una primera sub-placa (1111) y una segunda sub-placa (1112) conectadas integralmente, y la segunda sub-placa (1112) se extiende y se estrecha gradualmente en una dirección alejada de la primera sub-placa (1111).
2. El soporte (11) según la reivindicación 1, en el que la parte de soporte (111) comprende una primera superficie (111a) y una segunda superficie (111b) dispuestas de manera opuesta, el componente electrónico (12) está configurado para ser fijado a la primera superficie (111a), y las dos paredes laterales (112) están dispuestas en la segunda superficie (111b).
3. El soporte (11) según la reivindicación 1 o 2, en el que una dirección de extensión de la segunda sub-placa (1112) es paralela a una dirección de extensión de las dos paredes laterales (112).
- 20 4. El soporte (11) según la reivindicación 2, en el que las dos paredes laterales (112) tienen forma de banda y están conectadas verticalmente a los bordes laterales de la segunda superficie (111b) de la parte de soporte (111).
5. El soporte (11) según la reivindicación 1, en el que el soporte (11) tiene además una primera estructura de limitación (1113) de posición, la primera estructura de limitación (1113) de posición comprende dos protuberancias (1113a) en forma de banda, las dos protuberancias (1113a) en forma de banda sobresalen de la parte de soporte (111) y están
- 25 dispuestas de manera opuesta, y el componente electrónico (12) está configurado para ubicarse entre las dos protuberancias (1113a) en forma de banda.
6. El soporte (11) según la reivindicación 5, en el que la primera estructura de limitación (1113) de posición está dispuesta en la parte de soporte (111), y las dos protuberancias (1113a) en forma de banda se extienden en una dirección longitudinal de la parte de soporte (111).
- 30 7. El soporte (11) según la reivindicación 5, en el que el soporte (11) tiene una protuberancia de limitación (1114), la protuberancia de limitación (1114) sobresale de la parte de soporte (111), y la protuberancia de limitación (1114) está ubicada fuera de un área ocupada por las dos protuberancias (1113a) en forma de banda.
8. Un montaje de componentes electrónicos (1), que comprende:
- 35 un componente electrónico (12) y un soporte (11) para un componente electrónico (12) según la reivindicación 1.
9. El montaje de componentes electrónicos (1) según la reivindicación 8, en el que el soporte (11) tiene además una primera estructura de limitación (1113) de posición, la primera estructura de limitación de posición (1113) comprende dos protuberancias (1113a) en forma de banda, las dos protuberancias (1113a) en forma de banda sobresalen de la parte de soporte (111) y están dispuestas de forma opuesta, y el componente electrónico (12) está ubicado entre las dos protuberancias en forma de banda (1113a).
- 40 10. El montaje de componentes electrónicos (1) según la reivindicación 8, en el que el montaje de componentes electrónicos (1) comprende además una primera placa de circuito flexible (13), la primera placa de circuito flexible (13) está alojada al menos parcialmente en el espacio de alojamiento (113), un primer extremo de la primera placa de circuito flexible (13) está conectado eléctricamente al componente electrónico (12), y un segundo extremo de la primera placa de circuito flexible (13) se extiende fuera de la parte de soporte (111) en una dirección alejada del componente electrónico (12), se dobla a lo largo de un borde lateral de la parte de soporte (111) y se extiende dentro del espacio de alojamiento (113), y está conectado eléctricamente a la placa base (2).
- 45 11. El montaje de componentes electrónicos (1) según la reivindicación 10, en el que el soporte (11) tiene una protuberancia de limitación (1114), la protuberancia de limitación (1114) sobresale de la parte de soporte (111), y la protuberancia de limitación (1114) está ubicada fuera de un área ocupada por dos protuberancias (1113a) en forma de banda; la primera placa de circuito flexible (13) define un orificio de limitación (13a), y la protuberancia de limitación (1114) pasa a través del orificio de limitación (13a) de la primera placa de circuito flexible (13) para permitir que sea fijada la primera placa de circuito flexible (13).
- 50 12. El montaje de componentes electrónicos (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en el que el componente electrónico (12) es un sensor de luz.
- 55 13. El montaje de componentes electrónicos (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12, que además

comprende un conector eléctrico, en el que el conector eléctrico está configurado para conectarse entre un extremo de la primera placa de circuito flexible (13) lejos del componente electrónico (12) y la placa base (2).

5 14. Un terminal móvil (100), que comprende: una placa base (2) y un montaje de componentes electrónicos (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, estando el espacio de alojamiento (113) configurado para alojar al menos parcialmente una primera placa de circuito flexible (13) conectada eléctricamente al componente electrónico (12), y estando la primera placa de circuito flexible (13) conectada eléctricamente a la placa base (2).

10 15. El terminal móvil (100) según la reivindicación 14, en el que el terminal móvil (100) comprende además una segunda placa de circuito flexible (14) configurada para conectarse eléctricamente a una unidad de cámara (15), y la segunda placa de circuito flexible (14) está parcialmente alojada en el espacio de alojamiento (113).

15

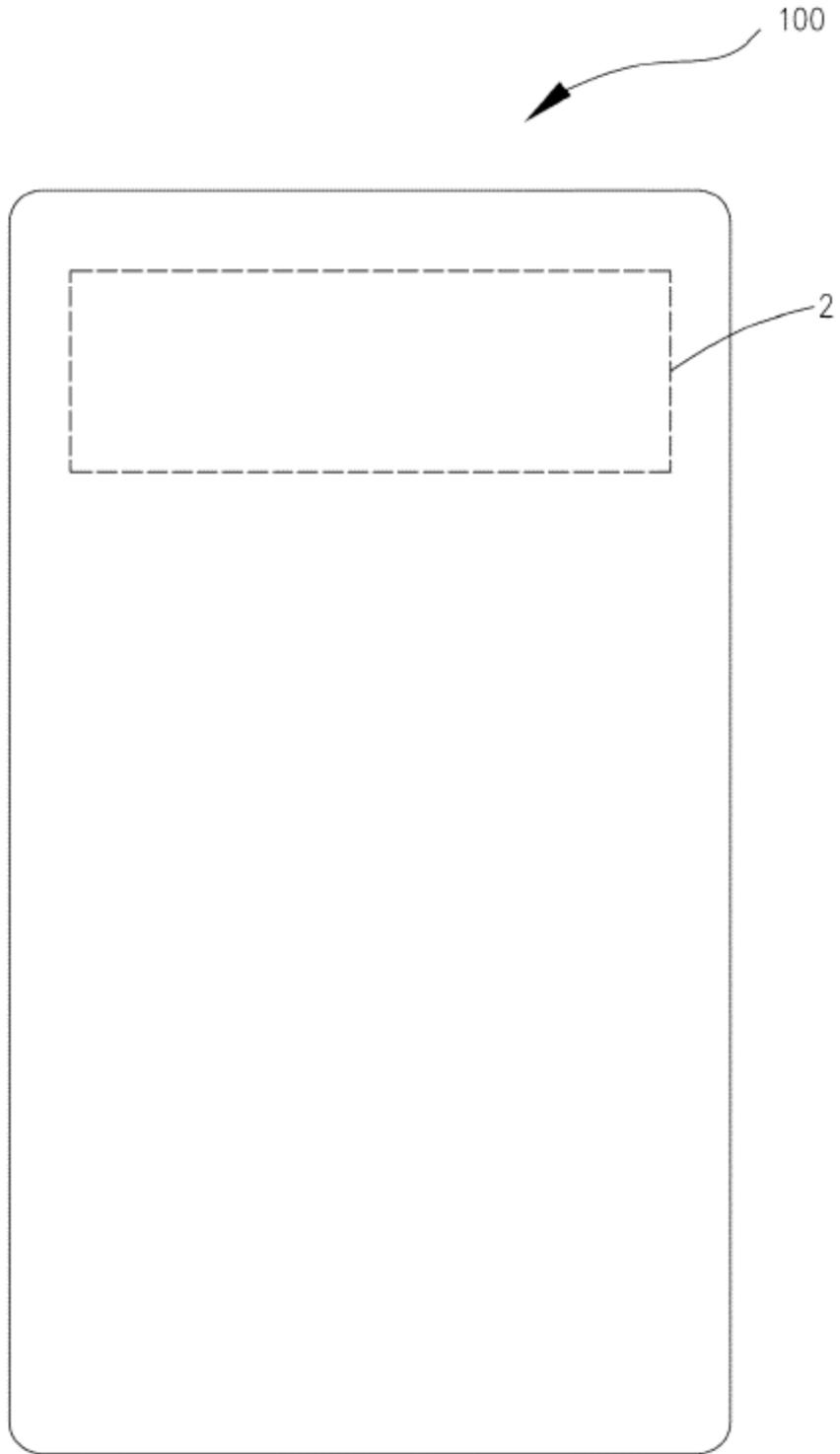


Fig. 1

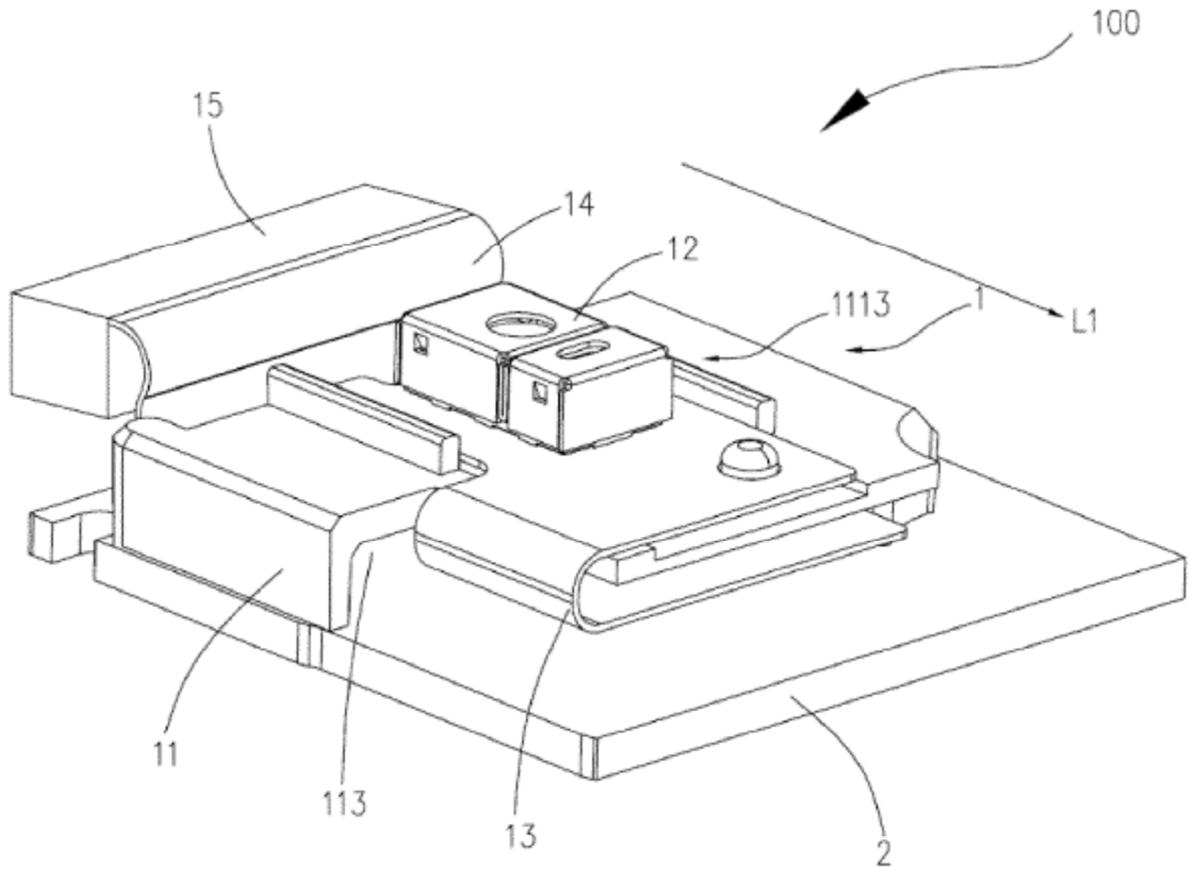


Fig. 2

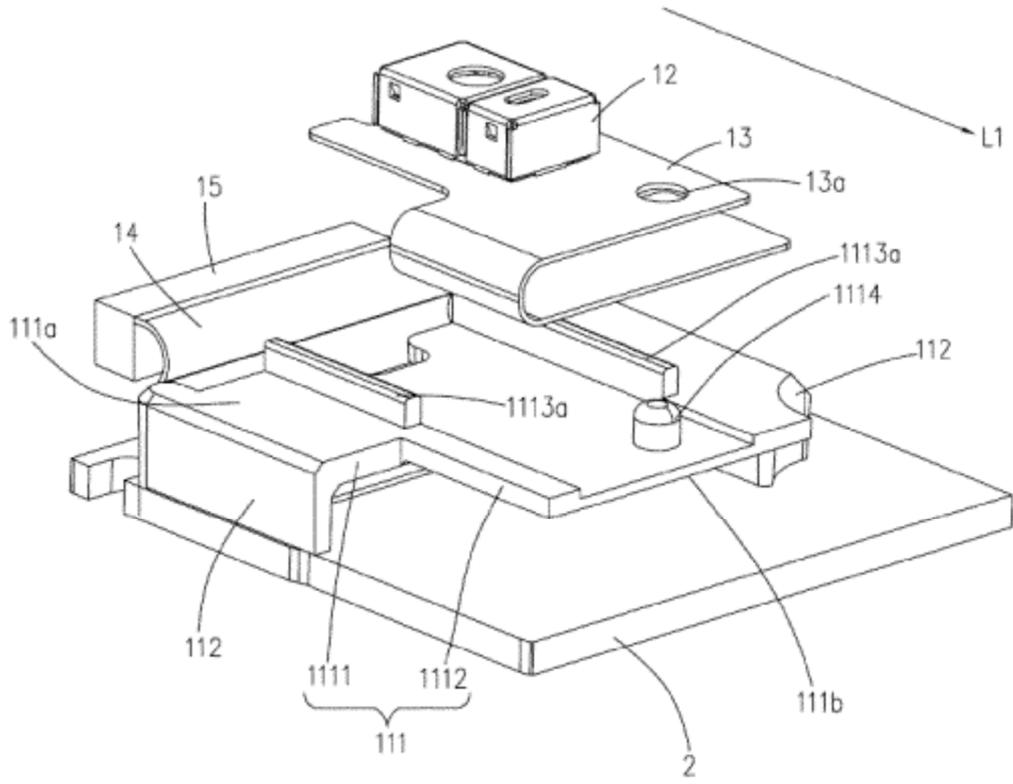


Fig. 3

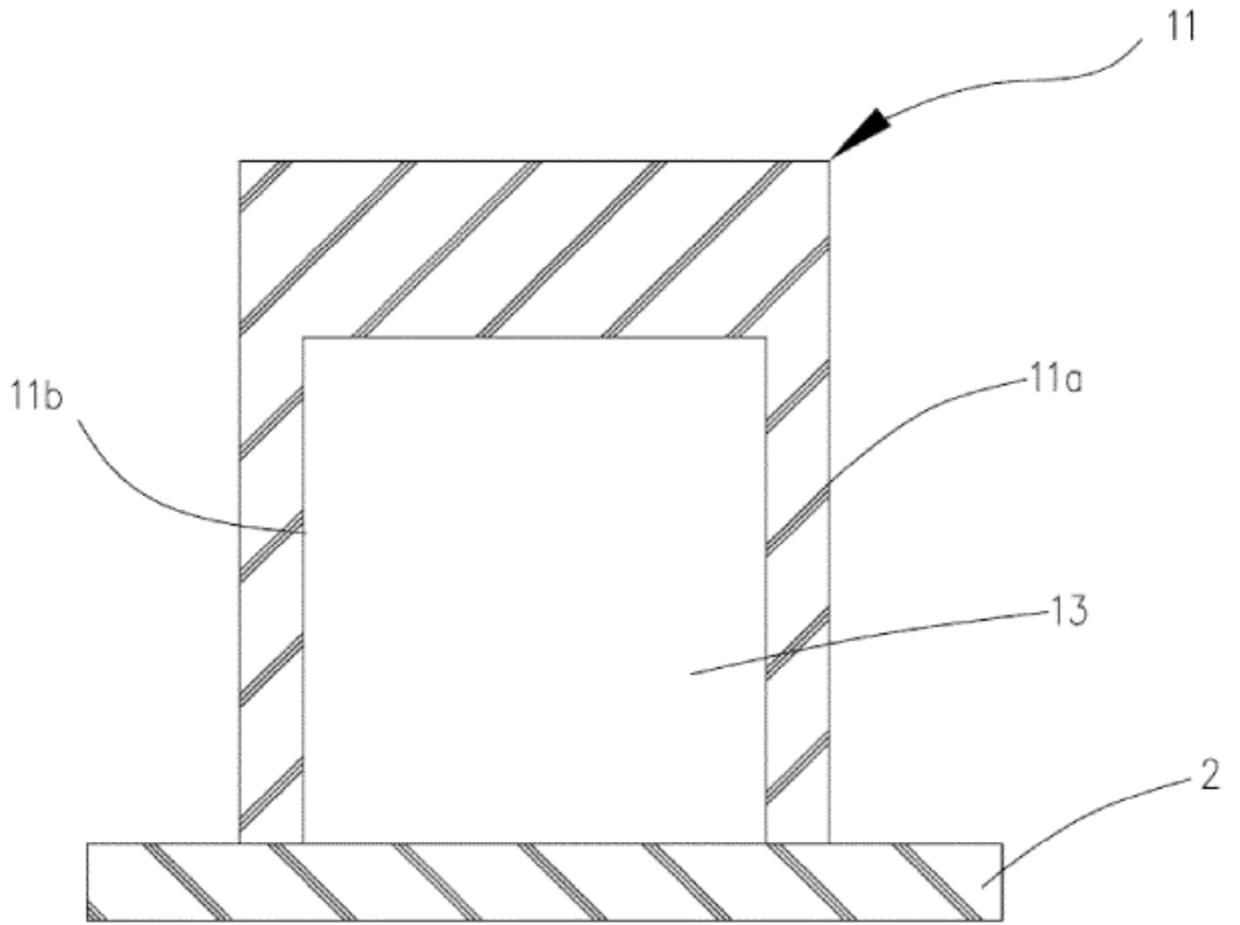


Fig. 4